

| |
|---------------------|
| 鑄造 ダイカスト |
| 鍛造 プレス |
| 材料 |
| 機械加工 |
| 樹脂加工 樹脂成形 |
| 工具刃具 |
| 表面処理 表面加工 熱処理 |
| 電子部品 実装 |
| 金型 治工具 |
| 装置 自動機 |
| 研究 開発 |
| ソフトウェア システム |
| 巻線 電工 |
| 製缶 溶接 |
| 食材生産 |
| 食材加工 |
| 食品加工 |
| 食品販売 |
| その他 |

日本エクシード株式会社

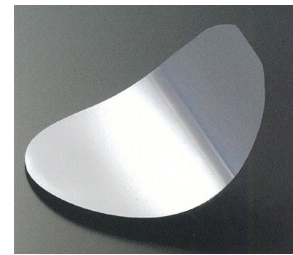
5超の研磨技術で、ナノを極め、いまを超える。

事業概要

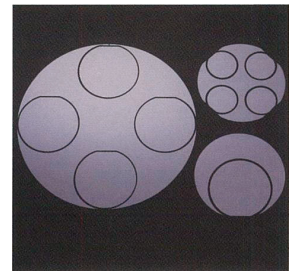
半導体デバイスの基本素材であるシリコン、酸化物、化合物の各種ウエーハ及び、金属材料の超精密研磨加工を得意としております。

素材毎に独自の加工技術を用い、比類ない精度と品質を提供しています。

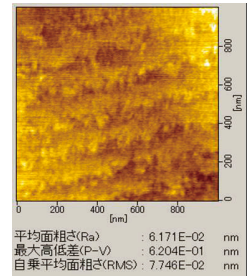
社名「エクシード」にふさわしく「を超える」ことを求めて、「人」「技術」を研ぎ、ナノメートルレベルでの果てしない要求に5超の研磨加工技術(超平滑化・超平坦化・超薄化・超無歪み化・超清浄化)でお客様の研究開発をお手伝いします。



Si薄化技術;φ150 50μm



Si特殊加工技術;サイズダウン加工



平均面粗さ(Ra) : 6.171E-02 nm
最大高低差(P-V) : 6.204E-01 nm
自乗平均面粗さ(RMS) : 7.746E-02 nm

SiC平滑化技術;Ra;0.062nm

優位技術など

- ・無歪み研磨加工技術による薄化技術
加工歪み層を極限まで無くす事により、数十μmまでの薄化が可能です。
- ・Si単結晶の特殊加工技術
Siウエーハのサイズダウンと穴開け加工が可能です。
- ・SiCウエーハの平滑化技術
最適化された研磨技術により、nmオーダーの平滑化が実現しています。
- ・各種金属素材の平滑研磨加工技術
半導体研磨技術を応用し、各種金属の平滑研磨が可能です。
- ・膜厚制御技術
ナノレベルで膜厚を制御する事が可能です。

| 企業概要 | 主要製品 | 主要取引先 | 各種認証, 認定, 資格等 |
|--|--------------|--------------------|---------------------|
| 代表者: 高山 直紀 資本金: 8,500万円 従業員: 120名 設立: 昭和36年3月 | 各種半導体素材の研磨加工 | 素材メーカー デバイスメーカー | ISO9001 ISO14001 |

| 主要設備 | | | 主要設備 | | |
|------|----|----|------|----|----|
| 設備名 | 能力 | 台数 | 設備名 | 能力 | 台数 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

お問い合わせ

- ◆連絡担当者: 中野 正晃
- ◆TEL: 0297-27-1531 ◆FAX: 0297-27-2181 ◆E-mail: sales@nihon-exceed.co.jp
- ◆URL: <http://www.nihon-exceed.co.jp/>
- ◆住所: 〒303-0043 茨城県常総市内守谷町4382-4